

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-024

上海天承科技股份有限公司

2026 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计 2026 年半年度实现营业收入 30,000.00 万元到 31,000.00 万元，与上年同期 21,314.99 万元相比，将增加 8,685.01 万元到 9,685.01 万元，同比增加 40.75%到 45.44%。

（2）预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,000.00 万元到 6,500.00 万元，与上年同期 3,673.36 万元相比，将增加 2,326.64 万元到 2,826.64 万元，同比增加 63.34%到 76.95%。

（3）预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,500.00 万元到 6,100.00 万元，与上年同期 3,174.02 万元相比，将增加 2,325.98 万元到 2,925.98 万元，同比增加 73.28%到 92.19%。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）利润总额：4,339.76 万元。归属于母公司所有者的净利润：3,673.36 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,174.02 万元。

(二) 每股收益：0.29 元/股。

(三) 营业收入：21,314.99 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

2026 年上半年，公司业绩较上年同期实现增长，主要系报告期内 PCB 行业景气度提升、下游客户订单增长，公司 PCB 专用湿电子化学品销售规模较上年同期增加。报告期内，公司积极推进产品结构优化、客户结构升级和市场拓展工作，高附加值产品销售占比提升，主要产品出货量同比增长，带动公司营业收入和盈利能力同步提升。

同时，公司持续加强成本管控、生产效率提升及供应链管理，产能利用率及运营效率有所提升。随着公司重点客户认证、产品导入及批量供应工作的持续推进，公司业务规模效应逐步显现，对报告期内业绩增长形成积极贡献。

四、风险提示

(1) 本次业绩预告是公司财务部门基于目前经营情况、财务资料及自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。公司 2026 年半年度报告编制工作尚在进行中，最终财务数据可能与本次业绩预告数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准。

(2) 报告期内，公司业绩较上年同期增长，主要受公司主营业务收入增长、产品结构优化、期间费用管控等因素影响。上述影响因素与公司所处行业环境、市场需求、产品价格、成本水平及经营管理情况等密切相关，如未来相关因素发生不利变化，公司经营业绩仍可能存在波动风险。

(3) 截至本公告披露日，公司未发现可能对本次业绩预告准确性产生重大影响的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日